

厦门信达股份有限公司

董事会关于募集资金二〇一九年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引规定，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）现将二〇一九年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

截至2018年12月31日，2013年非公开发行股票累计使用募集资金67,492.56万元，已完成募集资金使用。募集资金专项账户余额426.65万元为利息收入及现金缴存，已转至一般账户使用，并办理募集资金专项账户注销。截至2019年3月29日，2013年非公开发行股票相关募集资金专项账户全部注销完毕。具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于募集资金使用的进展公告》，刊载于2019年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以下报告内容为公司2015年非公开发行股票募集资金使用情况。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】62号）核准，公司采用非公开发行股票方式，向6名特定对象共发行了95,729,013股人民币普通股（A股），发行价格为13.58元/股，募集资金总额为人民币1,299,999,996.54元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,278,147,028.63元。上述募集资金已于2016年1月26日到账，并经北

京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了【2016】京会兴验字第62000007号《验资报告》。

（二）募集资金使用及节余情况

1、以前年度已使用金额

截至2018年12月31日，募集资金累计投入93,566.75万元，尚未使用的金额为35,211.95万元（其中：募集资金余额34,248.01万元，募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额963.94万元）。

2、本期使用金额

2019年上半年，公司募集资金使用5,571.38万元，截至2019年6月30日，募集资金累计投入99,138.13万元，尚未使用的金额为29,731.69万元（其中：募集资金余额28,676.63万元，募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额1,055.06万元）。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合实际情况修订了《募集资金使用管理制度》。

根据《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2016年1月9日，公司已与保荐机构中信建投、上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行、厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部、兴业银行股份有限公司湖里支行签署了《募集资金三方监管协议》。2016年3月16日，募投项目实施主体，公司全资子公司福建省信达光电科技有限公司、厦门市信达光电科技有限公司、广东信达光电有限公司、厦门信达物联科技有限公司及保荐机构中信建投分别与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行、厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年6月30日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2019年6月30日，公司2015年非公开发行股票募集资金余额为29,731.69万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

不适用。

（四）募投项目先期投入及置换情况

2015年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

公司2015年第三次临时股东大会审议通过：如本次非公开发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后，予以置换。

2015年公司董事会审议通过《非公开发行股票预案》，自2015年6月9日至2016年3月31日，公司以自筹资金先期投入募投项目的实际金额为33,375,554.36元，具体情况为：1、信达光电LED显示屏封装产品扩产项目30,615,566.35元；2、信达物联安防技术服务平台项目2,759,988.01元。2016年7月21日，董事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用2015年非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为33,375,554.36元。

截至2019年6月30日，公司对上述预先投入募集资金已置换完毕。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（六）节余募集资金使用情况

不适用。

（七）超募资金使用情况

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。

（九）募集资金使用的其他情况

本报告期，公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）变更募集资金投资项目的理由

1、经公司第九届董事会2016年度第五次会议、2016年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品扩产项目”的募集资金投资额为61,814.70万元。为了充分利用公司现有厂房和加快公司LED封装产能升级，进一步增强公司LED封装的综合竞争力，公司拟将“信达光电LED封装及应用产品扩产项目”中的新建厂房和LED白光封装及应用产品生产线扩产项目变更为扩建4条LED封装产品生产线与新建LED产品综合实验室项目。项目名称由原“信达光电LED封装及应用产品扩产项目”变更为“信达光电LED封装扩产项目”，本次募集资金投资项目变更涉及金额总计61,814.70万元，占本次非公开发行股票募集净额的48.36%。

2、经公司第十届董事会2017年度第三次会议、2017年第三次临时股东大会

审议，通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司原计划于“信达物联安防技术服务平台项目”使用募集资金16,000.00万元。为了提升公司RFID电子标签产能，进一步增强公司物联网整体解决方案的综合竞争力，公司将“信达物联安防技术服务平台项目”的部分募集资金用于RFID产品设计和生产线的扩产，项目名称由原“信达物联安防技术服务平台项目”变更为“RFID产品设计和生产线二期扩建项目”，本次募集资金投资项目变更涉及金额总计14,983.99万元及募集资金专户后期利息收入，占本次非公开发行股票募集总金额的11.52%。

3、经公司第十届董事会2018年第二次会议、2018年第三次临时股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为适应LED封装市场发展的趋势，进一步布局并扩大高端产品市场，提升募集资金投入设备的使用效率，公司将“信达光电LED封装扩产项目”部分已投产设备租借给厦门市信达光电科技有限公司使用，该部分设备原值共计6,666.38万元，租赁期两年，租金为55.56万元/月，本次募集资金投资项目用途变更占本次非公开发行股票募集总金额的5.13%。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、独立董事关于募集资金二〇一九年半年度存放与使用情况的独立意见

经过对有关资料的审核，我们认为公司董事会编制的《募集资金二〇一九年半年度存放与使用情况的专项报告》能够真实、客观地反映公司募集资金存放与使用情况，符合证监会、深圳证券交易所、公司《募集资金使用管理制度》的相关规定和要求，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在重大差异。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 厦门信达股份有限公司

2019 年半年度

单位: 人民币万元

2015 年非公开募集资金											
募集资金总额		127,814.70									
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额		83,465.07									
累计变更用途的募集资金总额比例		65.30%									
报告期末投入募集资金总额		5,571.38									
已累计投入募集资金总额		99,138.13									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
2015 年非公开募集资金	1. 信达物联安防技术服务平台项目	是	16,000.00	1,096.54	1,096.54	100.00	2017 年 10 月 12 日	0.00	否	否	
	2. RFID 产品设计和生产线二期扩建项目	否	0.00	14,983.99	2,394.78	10,178.47	67.93	2019 年 12 月 31 日	-	不适用	否
	3. 信达光电 LED 封装扩产项目	是	64,000.00	61,814.70	2,986.59	37,848.52	61.23	2017 年 5 月 31 日	-699.32	否	否
	4. 信达光电 LED 显示屏封装产品扩产项目	否	11,000.00	11,000.00	190.01	11,014.59	100.13	2016 年 7 月 31 日	-243.18	否	否
	补充流动资金	否	39,000.00	39,000.00		39,000.01	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		——	130,000.00	127,895.23	5,571.38	99,138.13	——	——	-942.50	——	——
超募资金投向		不适用									
合计			130,000.00	127,895.23	5,571.38	99,138.13	——	——	-942.50	——	——

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内，信达光电 LED 封装扩产项目由于封装产品转型升级，用工短缺依然影响投产计划进度及项目效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无此种情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无此种情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无此种情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 7 月 21 日，董事会会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 33,375,554.36 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	信达光电 LED 封装扩产项目募集资金承诺投资总额由 64,000.00 万元调整为 61,814.70 万元，调整差额 2,185.30 万元系募集资金的承销费（包括保荐费）及其他发行费用扣减所致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 厦门信达股份有限公司

2019 年半年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
信达光电 LED 封装扩产项目	信达光电 LED 封装及应用产品扩产项目	61,814.70	2,986.59	37,848.52	61.23%	2017 年 05 月 31 日	-699.32	否	否
RFID 产品设计和生产线二期扩建项目	信达物联安防技术服务平台项目	14,983.99	2,394.78	10,178.47	67.93%	2019 年 12 月 31 日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	——	76,798.69	5,381.37	48,026.99	——	——	-699.32	——	——
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、“信达光电 LED 封装及应用产品扩产项目”变更为“信达光电 LED 封装扩产项目”，主要系 LED 行业封装市场需求不断增长，变更可有效利用现有场地资源，解决公司 LED 封装产能瓶颈，提升市场占有率，扩大和稳定市场地位，提升公司竞争力。该事项已经公司第九届董事会 2016 年度第五次会议，2016 年第二次临时股东大会审议通过；决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见 2016 年 7 月 23 日公布在中国证监会指定网站的公司公告。</p> <p>2、“信达物联安防技术服务平台项目”变更为“RFID 产品设计和生产线二期扩建项目”，主要系原项目由于终端市场和客户消费习惯还需培育，项目进度未达到预期，预计无法实现原定目标；而变更有利于扩大公司 RFID 电子标签产能，提高公司在鞋服零售行业物联网整体解决方案的开发能力，从而提高募集资金使用效率，提升市场竞争力。该事项已经公司第十届董事会 2017 年度第三次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过；决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见 2017 年 8 月 30 日公布在中国证监会指定网站的公司公告。</p> <p>3、公司将“信达光电 LED 封装扩产项目”部分已投产设备租借给厦门市信达光电科技有限公司使用，主要为适应 LED 封装市场发展的趋势，进一步布局并扩大高端产品市场，提升募集资金投入设备的使用效率。该事项已经公司第十届董事会 2018 年第二次会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过，决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见 2018 年 3 月 31 日公布在中国证监会指定网站的公司公告。</p> <p>“信达光电 LED 封装扩产项目”募集资金用途变更包含上述第 1 及第 3 项变更，本期实现效益含部分已投产设备租借给厦门市信达光电科技有限公司使用所产生的租金收入。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内，信达光电 LED 封装扩产项目由于封装产品转型升级，用工短缺依然影响投产计划进度及项目效益。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无此种情况。								